산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	정부혁신 보다나은 정부

2019년 12월 12일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12. 12(목) 오전 06시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 12. 11.(화)	담당부서	산업기술개발과
담당과장	이재식 과장(044-203-4530)	담 당 자	전소원 사무관(044-203-4535)

12개국 전문가들이 모여 글로벌 기술 협력을 모색

- 「2019년 글로벌 기술협력 포럼('19.12.12(목), 코엑스)」 개최
- 주한대사관 초청 R&D 간담회, 기술 세미나, 1:1 상담회 등 다양한 행사로 구성

□ **산업통상자원부**(장관 : 성윤모)는 '19.12.12(목) 10:30~20:00, 서울 코엑스에서 『**2019년 대한민국 산업기술 R&D 대전**』 행사의 일환으로 「**2019년 글로벌 기술협력 포럼**」을 개최하였다.

○ 동 행사는 '16년부터 **글로벌 기술 컨설팅** 및 **공동 기술개발**을 통해 **혁신을 추진**하는 **국내외 산학연**의 노력을 격려하고, **혁신주체간 기술협력 교류의 場**을 마련하기 위하여 **추진되는 행사**이다.

< 2019년 글로벌 기술협력 포럼 개요 >

· **(시간/장소)** '19.12.12(목) 10:30~20:00, 코엑스 3층 컨퍼런스룸 E1~E6
· **(참석자)** 산업부(주최), 한국산업기술진흥원(주관), 국내외 산학연 전문가 등 250여명
· **(주요내용)**
  - **(개회식)** 기조연설(Atlantic Council 부총장, 벨기에 IMEC 연구소 부소장), 유공자 포상(5점)
  - **(주한대사관 초청 R&D 간담회)** 12개국 20명 R&D 국제협력 담당자 참석
  - **(기술 세미나)** 차세대 전자부품, 미래 융복합 소재, 스마트 모빌리티 및 제조혁신
  - **(기타)** 산학연 1:1 기술 상담회 및 네트워킹 리셉션

○ 올해 제4회를 맞는 「**2019년 글로벌 기술협력 포럼**」은 **개회식, 주한대사관 초청 간담회, 기술세미나, 1:1 B2B 기술상담회** 및 **네트워킹 리셉션** 등 종일에 걸쳐 **다양한 기술협력 행사**로 구성되어 있다.

□ **개회식**(10:30~12:00)에서는 글로벌 주요 연구기관 전문가들의 **기조연설**과 올해 **산업기술 국제협력 분야 유공자**에 대한 **장관 포상을 수여**하였다.

○ **기조연설**에는 ❶美 주요 국제문제 싱크탱크인 **애틀란틱 카운슬**(Atlantic Council)의 **베리 파벨**(Berry Pavel) 부원장이 '**글로벌 가치사슬의 지정학적 변화**'와, ❷반도체 분야 세계 최고 연구소인 벨기에 **IMEC 연구소**의 **존 벡켈만스**(John Baekelmans) 부원장이 '**국제 공동 R&D의 미래**'에 관해 강연한다.

○ 또한, 산업기술 국제협력 분야 **연구개발 우수 수행자** 및 **R&D 수행기관 유공자** 총 **5인**에 대한 **산업통상자원부 장관 표창**이 수여될 예정이다.

< 2019년 산업기술 국제협력 유공자 명단 >

구분	성명	소속 / 직위	수상 사유
연구개발 우수 수행	이인혁	동진모타공업 대표이사	· 한-베트남 소재부품 R&D사업으로 '진동내구성이 우수한 엔진 쿨링모터 개발' 수행, 중국에 5년간 75만대 규모 수주
	김정동	라파스 CTO	· 재외한인공학자활용기술컨설팅지원사업을 통해 '마이크로니들 공정개발' 등 과제 기획 우수
	유준상	오이솔루션 상무	· 네덜란드, 핀란드 기업과 차세대 스마트 트랜시버 개발에 참여, 제품 사업화에 성공, 향후 관련제품 매출 230억 예상
지원기관 유공	남대경	전품연 실장	· 전자부품연구원 글로벌협력실장 · 국제기술협력지원센터 운영 등에 우수한 실적
	박정오	KIAT 선임연구원	· 한국산업기술진흥원 국제협력사업팀 · 국제공동 R&D 양자협력 과제 관리 등에 대한 우수한 실적

□ 이어서 한국에 주재중인 **외국대사관 내 R&D 업무를 담당**하는 **네덜란드 에바 위트만**(Eva Witteman) **부대사**를 비롯한 **총 12개국 20여명**을 초청하여 '**주한대사관 초청 R&D 간담회**(12:10~13:40)'를 개최하였다.

○ 산업부는 「**제조업 르네상스 비전 및 전략**」 등 최근 발표한 **산업 정책** 및 **R&D 추진 방향을 설명**하고, 향후 **효율적인 국제공동 R&D 추진**을 위한 **정책 개선 방안, 국가별 주요 이슈 및 애로사항** 등을 논의했다.

○ 향후 산업부는 안정적 글로벌 밸류 체인 확보를 위해 글로벌 **R&D**를 확대해 나가고, 중대형 R&D 규모의 비중도 확대해나갈 예정이다.

○ 또한, **국내에 소재한 해외 기업**과 **국내 소재 해외 R&D 센터의 국내 R&D 참여를 확대**할 수 있는 방안을 모색할 예정이다.

□ 오후에는 **차세대 전자부품, 미래 융복합 소재, 스마트 모빌리티 및 제조혁신** 등 총 3개 분과로 나뉘어 **글로벌 기술협력 세미나**(14:00~16:00)가 열렸다.

○ ❶**차세대 전자부품 분과**에서는 **전자부품연구원,** 독일 프라운호퍼, 미국 캔자스주립대, 싱가포르 난양공대, (주)오이솔루션 등 전문가들이 참여하여 시스템 반도체 등 차세대 부품 등에 관한 전문 강연과 토론을 진행했으며,

○ ❷**미래 융복합 소재 분과**에서는 **전자통신연구원,** 미국 노스캐롤라이나대, 싱가포르 A*STAR, (주)라파스 등 전문가들이 미래 소재, 센서, 통신장비 등에 관한 강연과 사례 발표, 토론을 추진했다.

○ ❸**스마트 모빌리티 및 제조혁신 분과**는 **한국자동차연구원**을 중심으로 미국 퍼듀대, 오스트리아 비엔나 공대 등이 참여하여 차세대 자동차 부품 및 미래차에 대한 강연과 토론 등을 진행했다.

□ 또한, 국내외 산학연 등 **12개국 100여개 기관**이 참여하는 **협력 아이디어 교류 및 기획** 등을 위한 **1:1 기술상담회**(16:00~18:00)와 **네트워킹 리셉션**(18:00~20:00)이 추진됐다.

□ **산업부 관계자**는 "향후 산업부는 미국, 독일, 벨기에 등 **해외 우수연구소와의 공동 기획**을 통한 **중대형 Top-down 과제 추진**을 확대해 나가고,

○ 지난 11월 한-아세안 정상회의의 후속 조치인 『**한-아세안 산업혁신기구』 설립**을 위한 **공동 작업반 착수·운영** 등 **아세안 내에서의 기술협력 활성화를** 추진할 예정"이라고 밝혔다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업기술개발과 전소원 사무관(☎ 044-203-4535)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 **「2019 글로벌 기술협력포럼」 행사 개요**

□ 행사 개요

○ **(목적)** 국내와 **산업기술 R&D** 산학연간 **기술 협력의 場**을 마련하고, **국내 소재 외국대사관**과의 **소통 강화**를 통한 국내외 **협력기회 확대**

○ **(일시/장소) '19.12.12(목)** 10:30~20:00, **코엑스 3층** 컨퍼런스룸(E1~E6)

○ **(주최/주관) 산업통상자원부** / 한국산업기술진흥원

○ **(참석자)** 국내외 산학연 관계자 등 약 **250여명**

○ **(주요내용)** 개회식(기조연설, 유공자 포상), 주한대사관 초청 간담회, 분야별 기술 세미나, 1:1 B2B 상담회, 네트워킹 리셉션 등

□ 행사 프로그램

시간	주요내용		비고
1부 : 글로벌 기술협력 포럼 개회식 (컨퍼런스룸 E5)			
10:30~10:35('5)	오프닝		-
10:35~10:40('5)	개회사		KIAT 김류선 본부장
10:40~10:45('5)	축사		산업부 이재식 과장
10:45~11:00('15)	글로벌 기술협력 유공자 포상식		산업부 장관 표창
11:00~12:00('60)	기조연설	글로벌가치사슬(GVC)의 지정학적 변화	(美)Atlantic Council
		국제공동 R&D 협력의 미래	(벨)imec
2부 : 주한 대사관 초청 R&D 간담회 및 국제협력 아카데미 (컨퍼런스룸 E3, E4)			
12:10~13:40('90)	주한 대사관 초청 R&D 간담회	산업기술국제협력 아카데미(사전등록자)	오찬 병행
3부 : 글로벌 기술협력 세미나 (3개 분과 구성, 컨퍼런스룸 E1, E2, E3)			
	차세대 전자부품 (반도체 등 전자부품)	**스마트 모빌리티 및 제조혁신** (차세대 자동차, 스마트 제조)	**미래 융복합 소재** (소재, 센서, 통신장비, 의료장비 등)
14:00~14:20('20)	R&D 동향 및 지원정책 소개		국제기술협력지원센터
14:20~15:00('40)	국제공동R&D 우수사례 발표		국내외 산학연
15:00~16:00('60)	기술개발 동향 및 협력 제안		
4부 : 글로벌 기술협력 B2B상담회 (컨퍼런스룸 E6)			
16:00~18:00('120)	국내외 산학연 기관 간 1:1 기술협력상담		사전매칭 90여건
5부 : 네트워킹 (컨퍼런스룸 300호)			
18:00~20:00('120)	네트워킹 리셉션		참가자 전원